

珠海市半导体行业协会

珠半协秘〔2026〕12号

关于组团参加 2026 年第 23 届深圳国际电子展暨嵌入式展、CIOE 中国光博会和 IICIE 国际集成电路创新博览会的通知

各有关企业：

为推动我市国家外贸转型升级基地（集成电路）建设，帮助企业开拓国内外市场，提升区域品牌影响力，根据珠海市高新区国家外贸转型升级基地（集成电路）工作站的参展安排，现组织企业抱团参加“2026 年第 23 届深圳国际电子展暨嵌入式展、CIOE 中国光博会和 IICIE 国际集成电路创新博览会”三展联展，诚挚邀请贵司参加本次珠海展团。现将有关事项通知如下：

一、展会情况

展会时间：2026 年 9 月 9 日-11 日

展会地点：深圳国际会展中心（宝安）

二、展会亮点

第 23 届深圳国际电子展暨嵌入式展，在深圳国际会展中心（宝安）与“CIOE 中国光博会”和“IICIE 国际集成电路创新

博览会”同期举办，总展面积超 340,000 m²，专业观众超 100000 人，总观众人次超 30 万人。研发、设计等观众占比 41.22%、采购、供应链管理等占比 14.67%、市场、销售、技术、生产制造等占比 26.34%。Elexcon2026 作为华南电子与嵌入式技术年度大展，Elexcon2026 集中展示嵌入式 AI 与边缘 AI、存储、SoC/MCU/MPU、无线技术、MEMS 传感、电源管理 IC、功率器件、工业电源、被动元件及 SiP/Chiplet 等先进封装方案。

Elexcon 电子展聚焦 AI 终端创新技术与解决方案，而光电技术与嵌入式系统的结合，正驱动智能终端向更高性能、更高集成度演进。三展同期举办，将打通上下游全链条资源，为企业提供从核心器件、硬件设计到系统集成的“一站式”对接平台，显著提升产业协作效率。

同期举办多场专业论坛：开幕主题演讲、第八届中国嵌入式技术大会、SiP China 第十届系统级封装大会、华南汽车电子采供对接会及 Kaifa Gala 大湾区开发者嘉年华等活动。展示全球产业动态及未来技术趋势。

三、展品范围

电子元器件：半导体 IC、电源、功率半导体、测试与测量、高速连接技术与连接器、线束/线缆与组件、继电器与开关、无源器件（容阻感/晶振）、MEMS 传感器、汽车电子、热管理、Sip 与先进封装等。

嵌入式：嵌入式处理器 MCU/MPU/SoC/FPGA/DSP、嵌入式 AI 与边缘计算、存储、嵌入式模块、开发板、嵌入式操作系统、调试与仿真工具、有线/无线通信模组、传感器与执行器、电源管理 IC、AIoT 解决方案等。

四、珠海展团情况

本届深圳国际电子展暨嵌入式系统展协会将组团参加。珠海展团将设立 54 m² 特装展位（展位号：14B68），以珠海整体形象参展，突出推介珠海基地内优秀企业和产品。展位面向珠海基地集成电路企业，符合条件的企业可入驻珠海公共展位。

五、报名办法

请有意向参展及采购的企业于2026年8月14日17:00前填写附件表格以邮件形式发送至协会邮箱：member@zhisia.org.cn。

（注：名额有限，先到先得。请有兴趣的企业抓紧时间报名）

联系人：金子杨，联系电话：13726259646

附件：1、境内（外）展会参展报名表（合同书）

2、参展企业及展品信息征集表

3、参展人员信息登记表

